

※本リリースは 2026 年 3 月 25 日に発表されたリリースを訳したものです

## タワーセミコンダクター、日本における 300mm 生産能力拡張計画を発表

### TPSCo 再編を推進しつつ、差別化された光学・フォトニクスプラットフォームを強化し、 高付加価値技術分野での成長を加速

イスラエル、ミグダルハエメク – 2026 年 3 月 25 日 – 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファウンドリである[タワーセミコンダクター](#)（NASDAQ/TASE: TSEM）は本日、日本における事業体制の戦略的再編および 300mm 生産能力の拡張計画を発表しました。

現在、日本での事業はタワー パートナース セミコンダクター株式会社[TPSCo]（タワー： 51%、ヌヴォンテクノロジー ジャパン株式会社（NTCJ）： 49%出資）として運営されていますが、本再編により、300mm 工場（Fab 7: 富山県魚津市）の完全所有権をタワー、200mm 工場（Fab 5: 富山県砺波市）の完全所有権を NTCJ が取得します。

本戦略的再編の一環として、両社は長期の相互供給契約を締結し、既存顧客への安定供給体制を継続します。これにより、既存のタワーおよび NTCJ の顧客に対して、供給やオペレーションに支障が生じることはありません。

本再編は、通常のクローニング条件の充足および関係当局の承認取得を前提として、2027 年 4 月 1 日の完了を予定しています。

TPSCo は、これまでタワーの連結子会社として、優れたオペレーションおよび研究開発能力を発揮し、タワーと密接に連携しながらグローバルな事業運営を行ってきました。

新たに設立するタワーの完全子会社は、Fab 7 に関するすべての製造装置、オペレーション、人材、および事業活動を保有することとなり、タワーのグローバルな戦略的基盤を一層強化します。また本合意に基づき、タワーは Fab 7 の既存の建屋および土地を取得できる権利を有しています。

さらに、正式申請を経て経済産業省の補助金承認を得られた場合、タワーは NTCJ との事前合意条件に基づき隣接地を取得し、300mm 生産能力および技術基盤の拡張を推進する計画です。本拡張が完了すると、既存設備を含めた生産能力は、現在の約 4 倍に達する見込みです。

タワーのシリコンフォトニクス技術はすでに Fab 7 において量産・出荷実績があることから、本投資による量産立ち上げはグリーンフィールド投資などと比べて大幅な加速が期待されます。拡張されるクリーンルームでは新規製造装置が導入されるごとに、シリコンフォトニクス製品の出荷は順次増加していく見通しです。

本拡張は、すでに安定した収益基盤を有する工場で実施され、拡張建設期間を通じて同様の状態を維持することを想定しています。これは、ゼロから立ち上げる新規工場や買収型拡張とは異なり、通常は数年を要するとされるプロセス開発、顧客認定、収益安定化を大幅に短縮することが可能です。

タワーセミコンダクターの最高経営責任者（CEO）であるラッセル・エルワンガーは次のように述べています。

「TPSCo は長年にわたる卓越したオペレーション力と協業の積み重ねによって素晴らしい会社に成長しました。パナソニックおよび NTCJ とのパートナーシップの歴史に感謝するとともに、今回の再編により、NTCJ との関係性を共同出資から長期的な供給および顧客パートナーシップへと発展させ、両社の成長戦略を支えていけることを大変嬉しく思います。」

さらにエルワンガーは次のように述べています。

「本取り組みにより、当社は差別化された光学およびフォトニクス技術プラットフォームを、収益性の高い 300mm 工場の生産能力の大規模拡張を通じて一層強化することが可能になります。経済産業省と緊密に連携しながら、フォトニクス分野のイノベーションを推進し、当社および顧客にとっての長期的な成長基盤を構築するとともに、日本の半導体産業およびエコシステムの強化に貢献してまいります。」

## タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載、モバイル、インフラ、医療、航空宇宙・防衛など幅広い成長市場のお客様に向けて集積回路(IC)の技術開発・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先進的かつ革新的なアナログテクノロジーの提供を通じ、世界に新しいサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiPho、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-imaging sensor、ディスプレイ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスの設計支援環境を整備し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。マルチファブによる供給体制と拡張された生産能力を提供するため、タワーセミコンダクターは現在、イスラエルに 1 拠点(200mm)、米国に 2 拠点(200mm)、また、日本ではタワーセミコンダクターが 51%の株式を保有する TPSCo に 2 拠点(200mm 及び 300mm)の生産拠点を有し、イタリアのアグラテでは 300mm 工場を ST Microelectronics と共有しています。詳細は [www.towersemi.com](http://www.towersemi.com) をご覧ください。

***Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements***

This press release includes forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties. Actual results may vary from those projected or implied by such forward-looking statements. A complete discussion of risks and uncertainties that may affect the accuracy of forward-looking statements included in this press release or which may otherwise affect Tower's business is included under the heading "Risk Factors" in Tower's most recent filings on Forms 20-F, F-3, F-4 and 6-K, as were filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and the Israel Securities Authority. Tower does not intend to update, and expressly disclaim any obligation to update, the information contained in this release.

**Tower Semiconductor Company Contact:** Orit Shahaar | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**Tower Semiconductor Investor Relations Contact:** Liat Avraham | +972-4-6506154 | [liatavra@towersemi.com](mailto:liatavra@towersemi.com)